

第1回 先端電子デバイス接着技術研究会 「エレクトロニクス機器のための接着」

2021年7月5日（月） Zoom Webinarによるon-line開催

- 13:15～13:30 開会の挨拶・研究会主旨説明
大阪大学 F3D実装協働研究所 所長 菅沼 克昭
- 13:30～14:20 高分子界面の理解と接着技術への展開
九州大学大学院工学研究院 田中 敬二 教授
- 14:20～15:10 プリント配線板向け電解銅箔の製品・技術動向
三井金属鉱業株式会社 森 健治 氏

会員登録フォームにご記載の上、メールまたはFAXにてお申し込みください
f3d@sanken.osaka-u.ac.jp（又はFAX:06-6879-8488）